

证券代码：920526

证券简称：凯华材料

公告编号：2026-043

天津凯华绝缘材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 投资者关系活动类别

☐ 特定对象调研

☒ 业绩说明会

☐ 媒体采访

☐ 现场参观

☐ 新闻发布会

☐ 分析师会议

☐ 路演活动

☐ 其他

二、 投资者关系活动情况

活动时间：2026 年 9 月 3 日(周四)下午 15:00~17:00

活动地点：公司通过全景网“投资者关系互动平台”(<https://ir.p5w.net>)采用网络远程的方式召开业绩说明会

参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2026 年半年报业绩说明会的投资者

上市公司接待人员：公司董事、总经理任开阔先生；公司财务总监兼董事会秘书郝艳艳女士

三、 投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会公司就投资者关注的问题进行了沟通与交流，主要问题及回复如下：

1、下游 MLCC 行业资本开支周期性波动，备件、配套材料能否平滑业绩季度波动？

回复：您好，感谢您的关注。MLCC 是贴片陶瓷电容，环氧粉末包封料主要用于带引线的圆片陶瓷电容器，下游 MLCC 行业的周期性波动会对公司业绩有一定的影响，但影响不大。

2、环氧塑封料尚处于市场培育期，切入车载分立器件客户认证，主要现实卡点是什么？

回复：您好，感谢您的关注。目前环氧塑封料尚处于市场培育期，客户认证周期较长，且需要符合验厂条件。目前老厂区不符合客户验厂条件，只是试送样，待新厂区建成后邀请客户验厂并正式送样验证。

3、有机硅新材料拓展，该业务内部设置怎样的订单、盈利评估与止损标准？

回复：您好，感谢您的关注。目前关于有机硅材料的拓展，仅做小规模前期技术研究，主要是为了积累技术经验，待后期技术完善和成熟之后，公司内部再做详细的规划。

4、高端 EMC 先进封装材料暂未布局，研发资源有限，如何规划中长期技术路线？

回复：您好，感谢您的关注。目前，公司在研发资源有限的情况下，一方面立足环氧粉末包封料的主业优势，拓展其新应用场景，开发新的业务增长点；另一方面，加强环氧塑封料的研究开发，稳定完善工艺水平，推动现有塑封料业务放量。待条件成熟后再考虑高端 EMC 先进封装材料相关布局。

5、环氧粉末包封料、环氧塑封料、有机硅多产品线并行，资本开支紧张时资源如何倾斜？

回复：您好，感谢您的关注。如遇资本开支紧张时，公司一般会做如下安排：对于环氧粉末包封料，优先保障，聚焦产线降本、工艺优化与客户维护，稳定现金流；对于环氧塑封料，利用现有条件小批量试产，侧重研发投入；对于有机硅，暂缓重资本投入，仅做小规模前期技术研究和积累。

6、环氧粉末包封料面临同行低价竞争，车规级产品放量，如何维持整体

毛利率水平？

回复：您好，感谢您的关注。关于维持毛利率水平方面，公司主要采取如下应对措施：1、加强研究开发，提升产品的质量和性能，在市场竞争方面提升议价能力；2、开发新的业务增长点，提升公司的盈利能力；3、加强成本费用的管控。

7、海外头部被动元件客户占比较高，寄售模式下，如何管控存货与回款风险？

回复：您好，感谢您的关注。一般寄售模式的客户规模较大，经营相对规范，客户按确定账期正常回款，回款情况良好，在寄售模式下公司主要通过定期盘点和每月定期对账的方式加强存货的管控。

8、环氧树脂、硅微粉原料波动较大，除锁价采购外，工艺端有哪些降本手段？

回复：您好，感谢您的关注。关于公司工艺端降本手段主要有：一方面优化生产工艺、加强物料管控、减少生产浪费；另一方面加强研究开发，在研发过程中重视工艺的可实现问题，提高合格率，降低返工率。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会

2026年9月4日